

新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策

<div>国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知</div> <div>国发〔2020〕8号</div>	
<div>各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：</div> <div>现将《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》印发给你们，请认真贯彻落实。</div>	
<div>国务院</div> <div>2020年7月27日</div>	

集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）印发以来，我国集成电路产业和软件产业快速发展，有力支撑了国家信息化建设，促进了国民经济和社会持续健康发展。为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定以下政策。

一、财税政策

（一）国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所得税。国家鼓励的集成电路线宽小于65纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。国家鼓励的集成电路线宽小于130纳米（含），且经营期在10年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。国家鼓励的线宽小于130纳米（含）的集成电路生产企业纳税年度发生的亏损，准予向以后年度结转，总结转年限最长不得超过10年。

对于按照集成电路生产企业享受税收优惠政策的，优惠期自获利年度起计算；对于按照集成电路生产项目享受税收优惠政策的，优惠期自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起计算。国家鼓励的集成电路生产企业或项目清单由国家发展改革委、工业和信息化部会同相关部门制定。

（二）国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件由工业和信息化部会同相关部门制定。

（三）国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税。国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业清单由国家发展改革委、工业和信息化部会同相关部门制定。

（四）国家对集成电路企业或项目、软件企业实施的所得税优惠政策条件和范

围，根据产业技术进步情况进行动态调整。集成电路设计企业、软件企业在本政策实施以前年度的企业所得税，按照国发〔2011〕4号文件明确的企业所得税“两免三减半”优惠政策执行。

（五）继续实施集成电路企业和软件企业增值税优惠政策。

（六）在一定时期内，集成电路线宽小于65纳米（含）的逻辑电路、存储器生产企业，以及线宽小于0.25微米（含）的特色工艺集成电路生产企业（含掩膜版、8英寸及以上硅片生产企业）进口自用生产性原材料、消耗品，净化室专用建筑材料、配套系统和集成电路生产设备零配件，免征进口关税；集成电路线宽小于0.5微米（含）的化合物集成电路生产企业和先进封装测试企业进口自用生产性原材料、消耗品，免征进口关税。具体政策由财政部会同海关总署等有关部门制定。

（七）在一定时期内，国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，以及第（六）条中的集成电路生产企业和先进封装测试企业进口自用设备，及按照合同随设备进口的技术（含软件）及配套件、备件，除相关不予免税的进口商品目录所列商品外，免征进口关税。具体政策由财政部会同海关总署等有关部门制定。

（八）在一定时期内，对集成电路重大项目进口新设备，准予分期缴纳进口环节增值税。具体政策由财政部会同海关总署等有关部门制定。

二、投融资政策

（九）加强对集成电路重大项目建设的服务和指导，有序引导和规范集成电路产业发展秩序，做好规划布局，强化风险提示，避免低水平重复建设。

（十）鼓励和支持集成电路企业、软件企业加强资源整合，对企业按照市场化原则进行的重组并购，国务院有关部门和地方政府要积极支持引导，不得设置法律法规政策以外的各种形式的限制条件。

（十一）充分利用国家和地方现有的政府投资基金支持集成电路产业和软件产业发展，鼓励社会资本按照市场化原则，多渠道筹资，设立投资基金，提高基金市场化水平。

（十二）鼓励地方政府建立贷款风险补偿机制，支持集成电路企业、软件企业通过知识产权质押融资、股权质押融资、应收账款质押融资、供应链金融、科技及知识产权保险等手段获得商业贷款。充分发挥融资担保机构作

用，积极为集成电路和软件领域小微企业提供各种形式的融资担保服务。

（十三）鼓励商业性金融机构进一步改善金融服务，加大对集成电路产业和软件产业的中长期贷款支持力度，积极创新适合集成电路产业和软件产业发展的信贷产品，在风险可控、商业可持续的前提下，加大对重大项目的金融支持力度；引导保险资金开展股权投资；支持银行理财公司、保险、信托等非银行金融机构发起设立专门性资管产品。

（十四）大力支持符合条件的集成电路企业和软件企业在境内外上市融资，加快境内上市审核流程，符合企业会计准则相关条件的研发支出可作资本化处理。鼓励支持符合条件的企业在科创板、创业板上市融资，通畅相关企业原始股东的退出渠道。通过不同层次的资本市场为不同发展阶段的集成电路企业和软件企业提供股权融资、股权转让等服务，拓展直接融资渠道，提高直接融资比重。

（十五）鼓励符合条件的集成电路企业和软件企业发行企业债券、公司债券、短期融资券和中期票据等，拓宽企业融资渠道，支持企业通过中长期债券等方式从债券市场筹集资金。

三、研究开发政策

（十六）聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、集成电路设计工具、基础软件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发，不断探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。科技部、国家发展改革委、工业和信息化部等部门优先支持相关创新平台实施研发项目。

（十七）在先进存储、先进计算、先进制造、高端封装测试、关键装备材料、新一代半导体技术等领域，结合行业特点推动各类创新平台建设。科技部、国家发展改革委、工业和信息化部等部门优先支持相关创新平台实施研发项目。

（十八）鼓励软件企业执行软件质量、信息安全、开发管理等国家标准。加强集成电路标准化组织建设，完善标准体系，加强标准验证，提升研发能力。提高集成电路和软件质量，增强行业竞争力。

四、进出口政策

（十九）在一定时期内，国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业需要临时进口的自用设备（包括开发测试设备）、软硬件环境、样机及部件、元器件，符合规定的可办理暂时进境货物海关手续，其进口税收按照现行法规执行。

（二十）对软件企业与国外资信等级较高的企业签订的软件出口合同，金融机构可按照独立审贷和风险可控的原则提供融资和保险支持。

（二十一）推动集成电路、软件和信息技术服务出口，大力发展国际服务外包业务，支持企业建立境外营销网络。商务部会同相关部门与重点国家和地区建立长效合作机制，采取综合措施为企业拓展新兴市场创造条件。

再次，《若干政策》特别强调了深化产业国际合作和产业生态建设。云道智造创始人屈凯峰指出，在有关国际合作的政策中鼓励集成电路产业和软件产业“走出去”，便利国内企业在境外共建研发中心，更好地利用国际创新资源提升产业发展水平，对企业帮助很大。国际工业软件的发展脚步先于国内，要用国际资源来推动国产工业软件的开发，用国际化带动国产化。

最后，《若干政策》对产业的发展还提出了一些新要求。魏少军指出：“我注意到《若干政策》的表述中多次出现‘国家鼓励的集成电路生产企业或项目……’的表述方式。这说明了国家对集成电路产业和软件产业的发展是持鼓励态度的，但不鼓励一窝蜂。因此各地不要盲目开展项目。”

为行业注入信心

《若干政策》的出台对集成电路和软件企业带来一系列实质性的利好。天津飞腾副总经理张承义表示，集成电路行业对我国电子信息行业乃至国民经济具有杠杆撬动作用，对于集成电路这一高度分工，同时又极其依赖生态的行业来说，《若干政策》在投融资、人才以及市场落地等方面的进一步支持，对于打通和拓展企业上市融资渠道、促进集成电路产业链的联动，以及做大做强人才培养体系具有积极的指导意义。

华大半导体相关负责人指出，降低税收以及实现整个产业链的覆盖，能有效降低全产业链发展的成本，让每一个环节都受益。产业发展

五、人才政策

（二十二）进一步加强高校集成电路和软件专业建设，加快推进集成电路一级学科设置工作，紧密结合产业发展需求及时调整课程设置、教学计划和教学方式，努力培养复合型、实用型的高水平人才。加强集成电路和软件专业师资队伍、教学实验室和实习实训基地建设。教育部会同相关部门加强督促和指导。

（二十三）鼓励有条件的高校采取与集成电路企业合作的方式，加快推进示范性微电子学院建设。优先建设培育集成电路产教融合型企业。纳入产教融合型企业建设培育范围内的试点企业，兴办职业教育的投资符合规定的，可按投资额30%的比例，抵免该企业当年应缴纳的教育费附加和地方教育附加。鼓励社会相关企业投资基金加大投入，支持高校联合企业开展集成电路人才培养专项资源库建设。支持示范性微电子学院和特色化示范性软件学院与国际知名大学、跨国公司合作，引进国外师资和优质资源，联合培养集成电路和软件人才。

（二十四）鼓励地方按照国家有关规定表彰和奖励在集成电路和软件领域作出杰出贡献的高端人才，以及高水平工程师和研发设计人员，完善股权激励机制。通过相关人才项目，加大力度引进顶尖专家和优秀人才及团队。在产业集聚区或相关产业集群中优先探索引进集成电路和软件人才的相关政策。制定并落实集成电路和软件人才引进和培训年度计划，推动国家集成电路和软件人才国际培训基地建设，重点加强急需紧缺专业人才中长期培训。

（二十五）加强行业自律，引导集成电路和软件人才合理有序流动，避免恶性竞争。

六、知识产权政策

（二十六）鼓励企业进行集成电路布图设计专有权、软件著作权登记。支持集成电路企业和软件企业依法申请知识产权，对符合有关规定的，可给予相关支持。大力发展集成电路和软件相关知识产权服务。

（二十七）严格落实集成电路和软件知识产权保护制度，加大知识产权侵权行为惩治力度。加强对集成电路布图设计专有权、网络环境下软件著作权的保护，积极开发和应用正版软件网络版权保护技术，有效保护集成电路和软件知识产权。

（二十八）探索建立软件正版化工作长效机制。凡在中国境内销售的计算机（含大型计算机、服务器、微型计算机和笔记本电脑）所预装软件须为正版软件，禁止预装非正版软件的计算机上市销售。全面落实政府机关使用正版软件的政策措施，对通用软件实行政府集中采购，加强对软件资产的管理。推动重要行业 and 重点领域使用正版软件工作制度化规范化。加强使用正版软件工作宣传培训和督促检查，营造使用正版软件良好环境。

七、市场应用政策

（二十九）通过政策引导，以市场应用为牵引，加大对集成电路和软件创新产品的推广力度，带动技术和产业不断升级。

（三十）推进集成电路产业和软件产业

集聚发展，支持信息技术服务产业集群、集成电路产业集群建设，支持软件产业园区特色化、高端化发展。

（三十一）支持集成电路和软件领域的骨干企业、科研院所、高校等创新主体建设以专业化众创空间为代表的各类专业化创新服务机构，优化配置技术、装备、资本、市场等创新资源，按照市场机制提供聚焦集成电路和软件领域的专业化服务，实现大中小企业融通发展。加大对服务于集成电路和软件产业的专业化众创空间、科技企业孵化器、大学科技园等专业化服务平台的支持力度，提升其专业化服务能力。

（三十二）积极引导信息技术研发应用业务发展服务外包。鼓励政府部门通过购买服务的方式，将电子政务建设、数据中心建设和数据处理工作中属于政府职责范围，且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的软件和信息化服务机构承担。抓紧制定完善相应的安全审查和保密管理规定。鼓励大中型企业依托信息技术研发应用业务机构，成立专业化软件和信息化服务企业。

（三十三）完善网络环境下消费者隐私及商业秘密保护制度，促进软件和信息化技术服务网络化发展。在各级国家机关和事业单位推广符合安全要求的软件产品和服务。

（三十四）进一步规范集成电路产业和软件市场秩序，加强反垄断执法，依法打击各种垄断行为，做好经营者反垄断审查，维护集成电路产业和软件产业市场竞争。加强反不正当竞争执法，依法打击各类不正当竞争行为。

（三十五）充分发挥行业协会和标准化机构的作用，加快制定集成电路和软件相关标准，推广集成电路质量评价和软件开发成本度量规范。

八、国际合作政策

（三十六）深化集成电路产业和软件产业全球合作，积极为国际企业在华投资发展营造良好环境。鼓励国内高校和科研院所加强与海外高水平大学和研究机构的合作，鼓励国际企业在中国建设研发中心。加强国内行业协会与国际行业组织的沟通交流，支持国内企业在境内外与国际企业开展合作，深度参与国际市场分工协作和国际标准制定。

（三十七）推动集成电路产业和软件产业“走出去”。便利国内企业在境外共建研发中心，更好利用国际创新资源提升产业发展水平。国家发展改革委、商务部等有关部门提高服务水平，为企业开展投资等合作营造良好环境。

九、附则

（三十八）凡在中国境内设立的符合条件的集成电路企业（含设计、生产、封装、测试、装备、材料企业）和软件企业，不分所有制性质，均可享受本政策。

（三十九）本政策由国家发展改革委同财政部、税务总局、工业和信息化部、商务部、海关总署等部门负责解释。

（四十）本政策自印发之日起实施。继续实施国发〔2000〕18号、国发〔2011〕4号文件明确的政策，相关政策与本政策不一致的，以本政策为准。

（上接第1版）中国半导体行业协会副理事长、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事长于燮康也表示：“通过对先进芯片制造企业和重点集成电路设计企业给予特别优惠的税收政策，一方面鼓励企业特别是集成电路制造企业加快技术进步步伐，尽快赶上国际先进水平；同时也引导各方面资源向重点企业集聚，促进一批重点设计企业做大做强。从全球半导体产业的发展过程可知，决定产业综合实力并不在于企业数量的多少，数量不多的大型企业占据市场大部分份额。通过政策引导，培育和形成一批具有全球竞争实力的企业，是提高下一阶段发展质量的关键之一。”

既是政策延续又存新意

我国对集成电路和软件产业的发展一向非常重视，此前就出台了《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）。而本次出台的《若干政策》在保持政策延续的基础上，又展现了许多新特征。

中国半导体行业协会副理事长、清华大学微电子所教授魏少军指出，首先，《若干政策》在保持了政策连续性的基础上做了进一步延伸，使国家政策适应新时期，可操作性上有了更大的保障。从2000年的“18号文”，2011年的“4号文”，到现在2020年的“8号文”，这些政策是一脉相承的，使

产业发展的政策环境有了长期性和延续性，企业在发展过程中会更放心。与此同时，《若干政策》也进行了适当的延伸，以集成电路领域的制造工艺为例，国家将对集成电路线宽小于28纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，给予企业所得税等方面的优惠，这体现了与时俱进的科学态度。

其次，《若干政策》的覆盖面更广，支持力度更大。华大半导体相关负责人指出，材料、装备、封测等环节在“4号文”和“18号文”中几乎没有涉及，但行业一直有这方面的诉求。《若干政策》将集成电路全产业链囊括进去，更加贴合企业的诉求。《若干政策》对于制造企业的利好，主要体现在对先进工艺制造企业的支持上，国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所得税。按照最新政策，税收优惠力度显然大于从前的“五免五减半”。《若干政策》对于装备、材料、封装、测试企业的税收优惠是前所未有的，利好主要体现在对符合条件的企业或项目，自获利年度起的两年间免征企业所得税。《若干政策》对于重点芯片设计企业的利好，主要体现在“此前从企业获利年度起第三到第五年减半征收”变为“减免征收”，而后续10%的优惠税率，目前大部分企业已经享受到了。王柏华则表示：“政策起到了引导性作用。这次政策给出的具体措施非常实惠，不仅是对企业进行税收减免，同时对投融资也给出了支持，这是一个大亮点。”

形成组合拳，解决钱的问题。但新政策在创新投入上只是泛泛而谈，缺少具体措施建议。集成电路作为创新驱动的产业，创新措施不落实，相当于纸上谈兵。今年是“十三五”的收官之年，国家科技重大专项也进入收尾阶段，后续发展路径并不清晰，如果出现断档，我们在产业上好不容易缩小的差距还会被拉大。

金芯智造相关负责人指出，一是希望政策的实施细则尽快出台，可以分门别类进行细化。二是希望各地可以根据各自的特点出台配套政策，同时做到“有所为有所不为”。三是产业需要普适的优惠政策，打造产业规模效应，也需要从局部进行重点突破。

屈凯峰认为，软件行业的核心要素是人才。国家的支持政策，包括各部委的科研经费，如何能更多地支持和激励研发人员，需要在具体的政策落实中继续细化。以往很多重点研发项目重在支持购买硬件设备，与软件行业的特征和发展需求不匹配。

浪潮集团执行总裁王柏华建议，要鼓励软件产业中树干、树根型企业 and 基础平台型企业，包括工业设计软件、仿真软件、智慧城市平台软件等企业发展。现在的政策还是相对宽泛，需要更明确重点支持方向和目标。

华大半导体相关负责人建议，相对国家政策而言，各个地方部门推出一些实施细则也很重要，希望国家发改委、工信部会同相关部门制定并尽快发布实施细则，也希望各地方政府团结各方力量，将地方的配套政策尽快出台，让企业能以最快的速度享受到政策红利，加快产业发展步伐。